

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-048

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）对截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350号）同意注册，本公司于2021年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,020.2448万股，每股发行价为15.23元，应募集资金总额为人民币45,998.33万元，根据有关规定扣除发行费用4,362.51万元后，实际募集资金净额为41,635.82万元。该募集资金已于2021年3月29日到账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0034号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年6月30日，募集资金专户余额为15,482.82万元，其中使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额15,000.05万元（包含东亚银行（中国）有限公司合肥分行的募集资金理财产品专用结算账户里期末尚未转回至募集资金

专项账户的利息 0.05 万元)，募集资金专户余额 482.77 万元。募集资金存储情况具体明细列示如下：

单位：元

银行账户名称	银行账号	2022 年 6 月 30 日 余额	备注
中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	34050146480800002478	3,717,724.23	
中国农业银行股份有限公司合肥分行	12187001040099999	399,491.65	
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011000711239	710,445.88	
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160001009365	90,000,000.00	大额存单
东亚银行（中国）有限公司合肥分行	149000252760400	60,000,500.00	结构性存款，该账户含有期末尚未转回至募集资金专项账户的利息金额 500 元
合计		154,828,161.76	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况说明

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司将该项目节余募集资金 6,849.44 万元（包含利息收入扣除银行手续费后净额 437.92 万元）永久性补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已对该募集资金专户办理注销手续，本次变更用途的募集资金占前次募集资金总额的比例为 15.40%。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐机构出

具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关公告。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

募集资金投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额(1)	实际投资总额(2)	差异(3) = (1) - (2)	差异原因
高端 PCB 激光直接成像 (LDI) 设备升级迭代项目	20,770.00	20,770.00	14,358.48	6,411.52	公司在保证项目建设质量的前提下，结合实际情况，节约了部分设备采购投入；同时加强项目实施管控，合理降低了项目投入金额。目前该项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
晶圆级封装 (WLP) 直写光刻设备产业化项目	9,380.00	5,880.00	1,019.05	4,860.95	该项目仍处于建设期
平板显示 (FPD) 光刻设备研发项目	10,836.00	8,630.82	4,469.85	4,160.97	该项目仍处于建设期
微纳制造技术研发中心建设项目	6,355.00	6,355.00	454.82	5,900.18	该项目仍处于建设期
合计	47,341.00	41,635.82	20,302.20	21,333.62	—

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2021 年 6 月 15 日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,884.91 万元置换预先投入的募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关公告。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于2021年4月22日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2021年5月14日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

2022年4月27日，经第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。

截止2022年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为15,000.00万元，公司使用闲置募集资金已购买未到期的理财产品的情况如下：

存放银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	CA20G12836 单位大额存单 G128 期3年	大额存单	5,000.00	2021.5.21-2024.5.21
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	单位大额存单新客 G07 期3年-CA22NG0736	大额存单	4,000.00	2022.2.25-2025.2.25
东亚银行（中国）有限公司合肥分行	澳元/美元双区间单层触及结构	结构性存款	6,000.00	2022.5.27-2022.8.17
合计			15,000.00	

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”有助于为公司未来的 OLED 高端产线直写光刻设备产业化打下坚实的基础，提高公司综合竞争力；“微纳制造技术研发中心建设项目”有助于公司对现有技术研发平台进行全面升级，改善公司的研发环境，公司的综合研发实力将得到进一步提升，上述两个项目产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日

附件：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：合肥芯基微电子装备股份有限公司

金

额单位：人民币万元

募集资金总额：41,635.82						已累计使用募集资金总额：20,302.20				
变更用途的募集资金总额：6,411.52						各年度使用募集资金总额：20,302.20				
变更用途的募集资金总额比例：15.40%						2021 年：14,830.68 2022 年 1-6 月：5,471.52				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高端 PCB 激光直接成像 (LDI) 设备升级迭代项	高端 PCB 激光直接成像 (LDI) 设备升级迭代项	20,770.00	20,770.00	14,358.48	20,770.00	20,770.00	14,358.48	6,411.52	2022 年 2 月

	目	目								
2	晶圆级封装 (WLP) 直写 光刻设备产 业化项目	晶圆级封装 (WLP) 直写 光刻设备产 业化项目	9,380.00	5,880.00	1,019.05	9,380.00	5,880.00	1,019.05	4,860.95	2023年2 月
3	平板显示 (FPD) 光刻 设备研发项 目	平板显示 (FPD) 光刻 设备研发项 目	10,836.00	8,630.82	4,469.85	10,836.00	8,630.82	4,469.85	4,160.97	2023年2 月
4	微纳制造技 术研发中心 建设项目	微纳制造技 术研发中心 建设项目	6,355.00	6,355.00	454.82	6,355.00	6,355.00	454.82	5,900.18	2023年2 月
合计			47,341.00	41,635.82	20,302.20	47,341.00	41,635.82	20,302.20	21,333.62	—